

希荻微电子集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

（草案）（修订稿）及审核问询函回复的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年5月13日收到上海证券交易所出具的《关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕12号）（以下简称《审核问询函》），并于2025年7月29日披露了《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2025年7月10日披露的《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书	修订情况说明
重大风险提示	1、更新了收购整合的风险
风险因素	1、更新了收购整合的风险

除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

根据上海证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》等相关文件。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日